

Manufacturing



Manual electroless Ag
plating equipment

リジット基板・フレキシブル基板 無電解 Ag めっき

～生産能力～

◎基板サイズ 510×610 mmまで

◎めっき仕様 Ag : 0.1～0.6 μ m

◎生産キャパシティ 約 2,000 m²/月

～特徴～

海外で採用実績の多いスターリングプロセスを採用しています

◎ブラックパット等の層間剥離が発生しない

◎完全鉛フリーめっき

◎半田付け性、接合強度に優れる

◎電気抵抗が低い

◎高周波基板への Final-Finish 処理として有望

☆無電解 Ag めっきは強酸のめっき液です。そのため試作時にご使用のレジストについての耐久性の確認が必要です。